

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2016-033

北京君正集成电路股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：

发明名称：芯片封装

专利号：ZL 2012 1 0057491.4

专利申请日：2012年03月06日

专利权人：北京君正集成电路股份有限公司

专利权期限：二十年

授权公告日：2016年05月18日

证书号：第2072381号

该发明所提出的芯片封装有效降低了产品成本及加工难度，显著增加产品的合格率。目前上述专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日